

公募型見積合わせ公告

国立大学法人大阪大学において、次のとおり公募型見積合わせ方式に付します。

1. 調達内容

- | | |
|--------------|--|
| (1) 調達番号 | 情報001 |
| (2) 調達件名及び数量 | チップ製造 一式
(内訳)
①マルチモーダルセンサ読出回路チップ製造 一式
②脳細胞スパイク計測回路チップ製造 一式
③脳細胞スパイク注入回路チップ製造 一式
④セキュアハードウェア回路チップ製造 一式
⑤ハードウェアトロイ特性評価チップ製造 一式
⑥極低温動作評価用チップ製造 一式
(詳細は、別紙 仕様書の通り) |
| (3) 納入期限 | ①～⑤ 令和7年1月31日
⑥ 令和7年2月28日 |
| (4) 請負場所 | 国立大学法人大阪大学大学院情報科学研究科 |

2. 見積参加資格

- (1) 国立大学法人大阪大学契約規則第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
- (2) 本学と取引実績のある者であること、若しくは、経理責任者が認めた者であること。

3. 見積書の提出場所等

- (1) 見積書の提出場所、契約条項を示す場所、仕様書及び国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得の交付場所及び問合せ先
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-5
国立大学法人大阪大学 情報科学研究科 会計係
電話 06-6879-4504
- (2) 国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得の入手方法
本公告の日から上記3(1)の交付場所にて交付します。また、インターネットにより本学ホームページにアクセスし、参加者心得を出力することもできます。
- (3) 見積書提出期限
令和6年11月29日 17時15分

4. その他

- (1) 契約保証金 免除
- (2) 契約書作成の要否 要
- (3) その他詳細は、国立大学法人大阪大学が定めた「国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得」に定めています。

チップ製造一式

仕様書

2024年11月

大阪大学大学院情報科学研究科

【件名】

- ① マルチモーダルセンサ読出回路チップ製造 一式

【概要】

大阪大学より提供するチップレイアウト図に基づいてマルチモーダルセンサ読出回路チップを製造する。

【詳細仕様】

1 回路レイアウト図

- ・マルチモーダルセンサ読出回路のレイアウト図面を GDS2 フォーマットの CAD データとして大阪大学より提供する。

2 製造仕様

- ・プロセス：TSMC0.18um Mixed Signal RF プロセス
- ・エクストラダイカットにより以下の面積のチップを切り出すこと
- ・面積：3.54mm x 1.74mm 以上
- ・厚さ：0.3mm 以上

3 使用方法

- ・搭載マルチモーダルガスセンサ読出回路の計測性能を評価する。

【一般的事項】

1 成果物

次の成果物を納入すること

- ・チップ 40個

2 納期

2025年1月31日(金)までに納品すること。

3 納入場所

大阪府吹田市山田丘 1-5

大阪大学大学院情報科学研究科 情報システム工学専攻 知的集積システム講座

4 その他

本仕様に定めない事柄について疑義が生じた場合には、本学担当者と協議のうえ、これを定める。

【件名】

② 脳細胞スパイク計測回路チップ製造 一式

【概要】

大阪大学より提供するチップレイアウト図に基づいて脳細胞スパイク計測回路チップを製造する。

【詳細仕様】

1 回路レイアウト図

・脳細胞スパイク計測回路のレイアウト図面を GDS2 フォーマットの CAD データとして大阪大学より提供する。

2 製造仕様

- ・プロセス：TSMC0.18um Mixed Signal RF プロセス
- ・エクストラダイカットにより以下の面積のチップを切り出すこと
- ・面積：3.54mm x 1.74mm 以上
- ・厚さ：0.3mm 以上

3 使用方法

- ・搭載脳細胞スパイク計測回路の脳細胞からのスパイク信号の計測性能を評価する。

【一般的事項】

1 成果物

次の成果物を納入すること

- ・チップ 40個

2 納期

2025年1月31日(金)までに納品すること。

3 納入場所

大阪府吹田市山田丘 1-5

大阪大学大学院情報科学研究科 情報システム工学専攻 知的集積システム講座

4 その他

本仕様に定めない事柄について疑義が生じた場合には、本学担当者と協議のうえ、これを定める。

【件名】

③ 脳細胞スパイク注入回路チップ製造 一式

【概要】

大阪大学より提供するチップレイアウト図に基づいて脳細胞スパイク注入回路チップを製造する。

【詳細仕様】

1 回路レイアウト図

・脳細胞スパイク注入回路のレイアウト図面を GDS2 フォーマットの CAD データとして大阪大学より提供する。

2 製造仕様

- ・プロセス：TSMC0.18um Mixed Signal RF プロセス
- ・エクストラダイカットにより以下の面積のチップを切り出すこと
- ・面積：3.54mm x 1.74mm 以上
- ・厚さ：0.3mm 以上

3 使用方法

- ・搭載脳細胞スパイク注入回路の脳細胞へのスパイク刺激信号の注入機能を評価する。

【一般的事項】

1 成果物

次の成果物を納入すること

- ・チップ 40個

2 納期

2025年1月31日(金)までに納品すること。

3 納入場所

大阪府吹田市山田丘 1-5

大阪大学大学院情報科学研究科 情報システム工学専攻 知的集積システム講座

4 その他

本仕様に定めない事柄について疑義が生じた場合には、本学担当者と協議のうえ、これを定める。

【件名】

④ セキュアハードウェア回路チップ製造 一式

【概要】

大阪大学より提供するチップレイアウト図に基づいてセキュアハードウェア回路チップを製造する。

【詳細仕様】

1 回路レイアウト図

・セキュアハードウェア回路のレイアウト図面を GDS2 フォーマットの CAD データとして大阪大学より提供する。

2 製造仕様

- ・プロセス：TSMC0.18um Mixed Signal RF プロセス
- ・エクストラダイカットにより以下の面積のチップを切り出すこと
- ・面積：3.54mm x 2.50mm 以上
- ・厚さ：0.3mm 以上

3 使用方法

- ・セキュアハードウェア回路に対して物理攻撃を行い、安全性を評価する。

【一般的事項】

1 成果物

次の成果物を納入すること

- ・チップ 40個

2 納期

2025年1月31日(金)までに納品すること。

3 納入場所

大阪府吹田市山田丘 1-5

大阪大学大学院情報科学研究科 情報システム工学専攻 知的集積システム講座

4 その他

本仕様に定めない事柄について疑義が生じた場合には、本学担当者と協議のうえ、これを定める。

【件名】

⑤ ハードウェアトロイ特性評価チップ製造 一式

【概要】

大阪大学より提供するチップレイアウト図（別紙）に基づいて、ハードウェアトロイ特性評価チップを製造する。

【詳細仕様】

1 回路レイアウト図

・ハードウェアトロイ特性評価回路のレイアウト図面を GDS2 フォーマットの CAD データとして大阪大学より提供する。

2 製造仕様

- ・プロセス：TSMC180nm Mixed Signal RF プロセス
- ・面積：5mm x 5mm
- ・厚さ：0.3mm 以上

3 使用方法

・搭載回路に対してサイドチャネル情報の計測を行い、ハードウェアトロイの存在有無を評価する。

【一般的事項】

1 成果物

次の成果物を納入すること

- ・チップ 20 個
(20 個のうち 15 個は CQFP208 パッケージに封入された状態)

2 納期

2025 年 1 月 31 日（金）までに納品すること。

3 納入場所

大阪府吹田市山田丘 1-5

大阪大学大学院情報科学研究科 情報システム工学専攻 知的集積システム講座

4 その他

本仕様に定めない事柄について疑義が生じた場合には、本学担当者と協議のうえ、これを定める。

【件名】

⑥ 極低温動作評価用チップ製造 一式

【概要】

大阪大学より提供するチップレイアウト図（別紙）に基づいて、極低温動作評価用チップを製造する。

【詳細仕様】

1 回路レイアウト図

・極低温動作評価用チップのレイアウト図面を GDS2 フォーマットの CAD データとして大阪大学より提供する。

2 製造仕様

- ・プロセス：TSMC22nm ULL プロセス
- ・面積：2mm x 1.5mm 以下

3 使用方法

- ・搭載回路の極低温動作特性を評価する。

【一般的事項】

1 成果物

次の成果物を納入すること

- ・チップ 100 個
(100 個のうち 10 個は CQFP1608 パッケージに封入された状態)

2 納期

2025 年 2 月 28 日（金）までに納品すること。

3 納入場所

大阪府吹田市山田丘 1-5

大阪大学大学院情報科学研究科 情報システム工学専攻 知的集積システム講座

4 その他

本仕様に定めない事柄について疑義が生じた場合には、本学担当者と協議のうえ、これを定める。

第2号様式

見 積 書

調達番号： 情報001

調達件名： チップ製造 一式

見 積 金 額 金 円也

国立大学法人大阪大学が定めた製造請負契約基準を熟知し、仕様書及び公募型見積合わせ方式参加者心得を承諾の上、上記の金額によって見積します。

令和 年 月 日

国立大学法人大阪大学 殿

住 所
会 社 名
氏 名
電話番号

[印]

- 1 見積金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額を記載してください。
- 2 見積書の日付は、提出日を記載してください。
- 3 本学が見積公告【2. 見積参加資格（1）（2）】以外に見積参加資格を示した場合、それを有しているかどうか証明するための書類を見積書に添付してください。

請負契約書(案)

請負の表示 チップ製造 一式

(内訳)

- | | |
|-----------------------|----|
| ① マルチモーダルセンサ読出回路チップ製造 | 一式 |
| ② 脳細胞スパイク計測回路チップ製造 | 一式 |
| ③ 細胞スパイク注入回路チップ製造 | 一式 |
| ④ セキュアハードウェア回路チップ製造 | 一式 |
| ⑤ ハードウェアトロイ特性評価チップ製造 | 一式 |
| ⑥ 極低温動作評価用チップ製造 | 一式 |

請負代金額 金 円也 (うち消費税額及び地方消費税額 円)

上記の消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。

発注者 国立大学法人大阪大学大学院情報科学研究科長 原 隆浩 と受注者 との間において、上記の請負業務（以下「業務」という。）について、上記の請負代金額で次の条項によって請負契約を結ぶものとする。

- 第1条 受注者は、別紙の仕様書に基づいて、業務を行うものとする。
- 第2条 業務は、受注者の事業所において、これをするものとする。但し、発注者の依頼により受注者の事業所以外で業務を実施する場合は、その限りではない。
- 第3条 受注者は、業務を行う上で知り得た発注者に関する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
- 第4条 受注者は、業務を行う上で知り得た個人情報については、別紙「個人情報取扱の特記事項」を遵守して取扱うものとする。
- 第5条 納入期限は、内訳①～⑤については令和7年1月31日まで、⑥については令和7年2月28日までとする。
- 第6条 受注者は、納入完了後、完了報告書を国立大学法人大阪大学情報科学研究科会計係に送付するものとする。
- 第7条 請負代金は、業務の完了確認後、その都度、当該月の翌々月末までに支払うものとする。
- 第8条 請負代金の請求書は、国立大学法人大阪大学情報科学研究科会計係に送付すべきものとする。
- 第9条 契約保証金は免除する。
- 第10条 この契約についての必要な細目は、別冊の国立大学法人大阪大学が定めた製造請負契約基準によるものとする。
- 第11条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者所在地の所轄裁判所の裁決により、これを解決するものとする。
- 第12条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

上記契約の成立を証するため発注者及び受注者は、次に記名し、印を押すものとする。
この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。

令和 年 月 日

発注者

吹田市山田丘1番5号

国立大学法人大阪大学

大学院情報科学研究科長 原 隆浩

受注者

(基本的事項)

第1 この契約により、発注者から業務を請け負った者(以下「受注者」という。)は、この契約による業務を行う上で、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

(秘密保持)

第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は本契約を履行する以外の目的に使用してはならない。

2 受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は本契約を履行する以外の目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知させなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(保管及び搬送)

第3 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。

(再委託の禁止)

第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。

(契約目的以外の利用等の禁止)

第5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報を当該業務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写及び複製の禁止)

第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報を複写若しくは複製してはならない。

(事故発生時の報告義務)

第7 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わねばならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(個人情報の返還等)

第8 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による業務に係る個人情報を速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。

(適正な管理)

第9 受注者は、この契約による業務を学外で実施する場合には、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。この場合において、発注者の求めに応じ、責任者等の管理体制及び個人情報の管理状況に係る検査に関する事項等についての書面を提出しなければならない。

(違反した場合の措置等)

第10 発注者は、受注者がこの特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。